

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-3

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月13日
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ） 采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长 曹建伟 副总裁、财务总监兼董事会秘书 陆晓雯 独立董事 张红英
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、晶盛领导好，曹总好，想问下未来几年半导体业务的比重大概会是多少，除了最新的碳化硅产业，公司目前还有哪些方面的前沿技术储备。最后我觉得晶盛是一家注重技术研发、稳步发展的企业，希望未来企业更进一步。谢谢。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。受益于半导体行业持续发展及国产化进程加快，公司半导体业务持续发展，截至2025年12月31日，公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超37亿元（含税），公司业绩信息请关注公司披露的定期报告。公司始终坚持技术创新引领与客户需求深度挖掘双轮驱动的研发体系，持续加大研发投入，构建核心技术护城河，保障公司核心竞争力的长期可持续。在半导体集成电路装备领域，公司率先实现8-12英寸大硅片制造装备的国产化突破与规模化应用，并向芯片制造和先进封装环节延伸布局。面向先进制程需求，公司开发8-12英寸减压外延设备、ALD等薄膜沉积装备，依托差异化技术路线与迭代创新的产品理念，为客户提供高适配性的国产化替代方案，助力半导体产业链自主可控。在化合物半导体装备领域，公司聚焦第三代半导体碳化硅全产业链装备</p>

研发，在晶体生长、精密加工、外延制备、芯片制造及关键检测等环节实现多项核心技术突破，完成多款关键装备的国产化替代，形成覆盖全工艺流程的系统解决方案能力，为第三代半导体产业规模化发展提供装备支撑。依托在硬脆晶体材料生长、加工及工艺集成领域的深厚技术积累，公司前瞻性布局高成长性半导体衬底材料业务，目前已形成碳化硅衬底、蓝宝石衬底、氮化硅陶瓷材料及培育金刚石的规模化产能。在半导体耗材领域，公司率先实现半导体级石英坩埚的国产替代，产品市场占有率持续领跑行业，并成功突破大尺寸半导体合成石英坩埚技术瓶颈。同时，公司积极延伸布局石英制品等关键辅材耗材，相关产品顺利通过客户验证并进入规模化量产阶段。在半导体精密零部件领域，公司持续突破精密制造工艺瓶颈，有效补齐部分关键零部件供应链短板，相关产品获得半导体产业链头部客户认证并实现批量供货，有力推动国产半导体装备核心部件自主可控进程。感谢您的关注。

2、晶盛现在目前宣传的都是先进碳化硅衬底企业，半导体设备公司，但是为什么股价走势每次都是跟光伏设备走？请问公司转型到了什么阶段？碳化硅或半导体设备带来的订单占公司整体收入的百分比是多少？

答：尊敬的投资者，您好。二级市场股价波动受宏观经济、行业周期、市场情绪等多重因素影响。受益于半导体行业持续发展及国产化进程加快，公司半导体业务持续发展，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超 37 亿元（含税），公司业绩信息请关注公司披露的定期报告。公司主营业务产品涉及半导体装备、半导体衬底材料以及半导体耗材及零部件领域。公司将继续坚持以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为企业使命，贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，以研发技术创新和组织管理创新构建新质生产力，持续深化半导体装备加材料的产业链协同布局，打造多元业务协同发展的平台型公司，以先进装备先进材料协同创新持续引领高质量发展，成为全球领先的半导体装备、材料、耗材及关键零部件供应商和综

合服务平台。感谢您的关注。

3、天岳先进 8 寸碳化硅市占率已经高达 50%。请问公司的 8 寸碳化硅衬底片目前市占率多少？8 寸碳化硅衬底明年内是否会出现产能过剩而大幅降价？

答：尊敬的投资者，您好。公司碳化硅衬底材料业务已实现 6-8 英寸碳化硅衬底规模化量产与销售，量产的碳化硅衬底核心参数指标达到行业一流水平，8 英寸碳化硅衬底技术和规模处于国内前列，成功获取主流客户批量订单，份额及产能快速提升。当前，全球碳化硅产业生态持续优化，规模化降本持续推进，新能源汽车 800V 高压需求加速释放，叠加 AI 数据中心高压电源、光伏储能逆变器等新应用场景不断渗透，碳化硅产业进入以技术壁垒与生态整合为核心的高质量发展阶段，市场空间有望持续扩大。感谢您的关注。

4、请问公司集成电路大硅片设备能否满足先进制程衬底的制造要求？

答：尊敬的投资者，您好。公司集成电路大硅片设备产品质量已达国际先进水平，能够满足不同客户需求。

5、请问 8 寸 sic 衬底的良率在多少？

答：尊敬的投资者，您好。公司量产的碳化硅衬底核心参数指标达到行业一流水平。感谢您的关注。

6、有注意到晶盛机电在光伏以外积极布局了企业第二增长曲线碳化硅等半导体材料和设备，能否说明下目前企业在手订单情况和后续半导体供应链的战略布局，以及面对国内外竞争和复杂的形式，为实现企业增收增益的经营措施。

答：尊敬的投资者，您好。受益于半导体行业持续发展及国产化进程加快，公司半导体业务持续发展，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超 37 亿元（含税），公司业绩信息请关注公司披露的定期报告。公司碳化硅衬底材料业

务已实现 6-8 英寸碳化硅衬底规模化量产与销售，量产的碳化硅衬底核心参数指标达到行业一流水平，8 英寸碳化硅衬底技术和规模处于国内前列；同时公司首条 12 英寸碳化硅衬底加工中试线已通线。公司高度重视碳化硅业务的发展，为把握市场机遇，我们正积极推动相关产能的全球化布局，公司浙江上虞及宁夏银川的碳化硅项目均已投产，马来西亚槟城的碳化硅衬底项目预计 2027 年投产。这些项目的顺利实施，将有力增强公司在碳化硅材料领域的技术实力、规模优势和全球供应保障能力。具体进展情况请关注公司后续的信息披露。感谢您的关注。

7、请问公司集成电路大硅片设备能否满足先进制程衬底的制造要求？

答：尊敬的投资者，您好。公司集成电路大硅片设备产品质量已达国际先进水平，能够满足不同客户需求。感谢您的关注。

8、2026 年半年和年报业绩能不能超预期好业绩

答：尊敬的投资者，您好。公司主营业务产品涉及半导体装备、半导体衬底材料以及半导体耗材及零部件领域。在半导体集成电路装备领域，公司实现半导体 8-12 英寸大硅片设备的国产化，并延伸拓展至芯片制造和先进封装领域；在化合物半导体装备领域，公司聚焦第三代半导体碳化硅装备研发，在晶体生长、加工、外延等环节成功突破多项核心技术；在新能源光伏装备领域，公司实现了硅片、电池片及组件环节核心设备的产业链闭环，是技术、规模双领先的光伏设备供应商。在半导体衬底材料领域，公司拥有碳化硅衬底材料、蓝宝石衬底材料及培育金刚石的规模化产能。在半导体耗材及零部件领域，公司布局光伏石英坩埚、半导体石英坩埚、金刚线及半导体精密零部件业务。公司始终紧跟半导体产业技术迭代趋势，建立多代产品同步研发，匹配行业技术升级节奏，保障产品长期竞争力。公司业绩信息请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注。